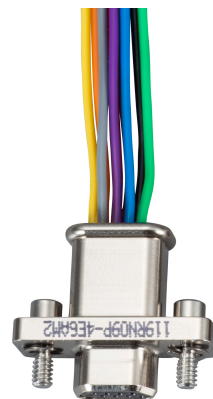
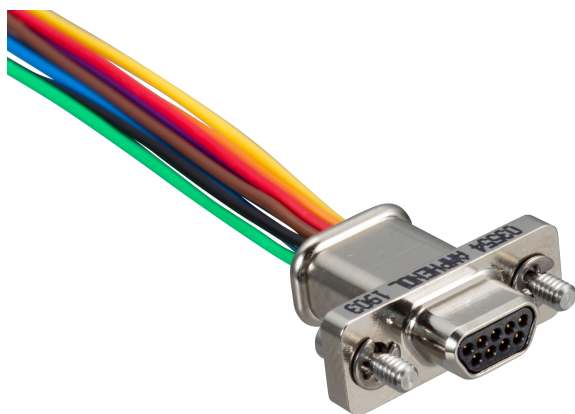


バックシェルー一体型Micro-D

THE NEXT DESIGN OF HIGH-QUALITY MICRO-D INTERCONNECTS



バックシェルー一体型Micro-Dは、コストダウン、省スペース、軽量化のニーズに応え、開発されました。既存のMIL-DTL-83513規格コネクタと完全嵌合し、従来品と同等の電気性能を発揮します。バックシェルと一体化しているため、作業工数を短縮できます。

優れた電気性能を維持しながら、コンパクト設計を実現した本製品は、ミサイル内の機器間接続など、高い信頼性と
ともに、スペースや重量制限が厳しい用途に最適です。

特長：

- ・ 既存のMIL-DTL-83513規格コネクタと完全嵌合
- ・ 従来のMicro-Dとバックシェルの組合せと比較し、大幅なコストダウン
- ・ あらゆる標準ケーブルを結線可能
- ・ 多彩なハードウェア（取付金具）オプションあり
- ・ メタルバンドで、シールドケーブルを簡単、確実に取付可能
- ・ RoHS対応可

機械特性：

シェル材質：アルミニウム合金
シェルめっき：アルマイト（陽極酸化処理）、カドミウム、金、
イリダイト/アロジン、無電解ニッケル、錫
コンタクト材質：銅合金（ニッケル下地に金めっき1.3 μ m）
絶縁体：PPS（ライトン）
適合ケーブル：NEMA-HP3
MIL-W-22759/11 (M83513 STD)
MIL-W-22759/33 (Space Grade)
非絶縁ソリッドワイヤ
ハードウェア材質：ステンレススチール（不動態化処理）

電気特性：

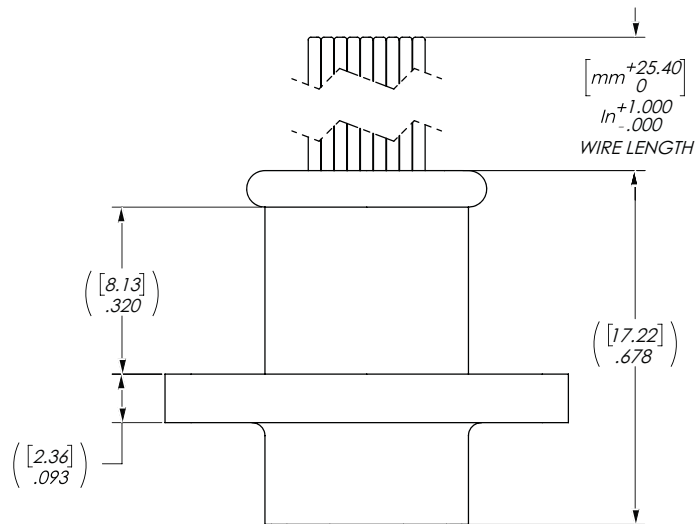
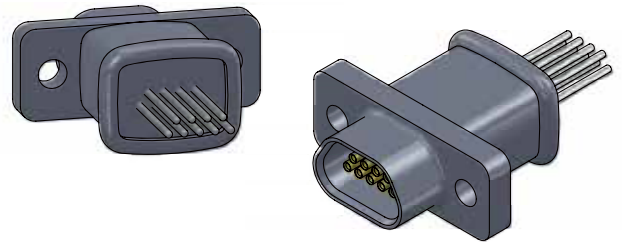
耐電圧： 600 Vac（海面位）
150 Vac（70k Ft.）
定格電流：3A（1コンタクトあたり）
絶縁抵抗：5.0 G Ω
接触抵抗：8.0 m Ω @ 3A

環境特性：

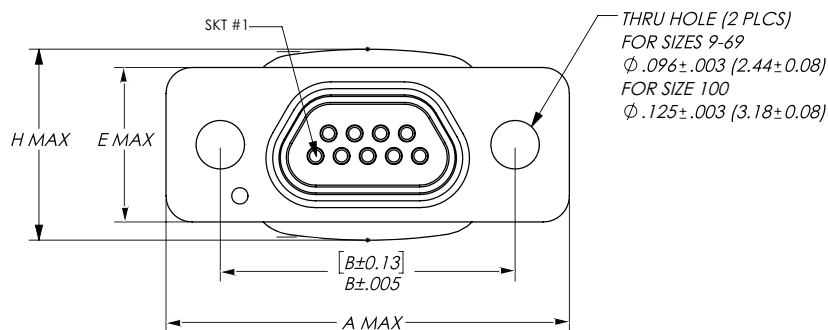
使用温度：-55° C ~ +125° C
耐振動： EIA-364-28, condition IV
耐腐食性（塩水噴霧）：EIA-364-26, condition B
耐湿性： EIA-364-31
耐液体性：MIL-DTL-83513

MICRO-D BANDIT SOCKET

INTEGRAL BACKSHELL



TOP VIEW

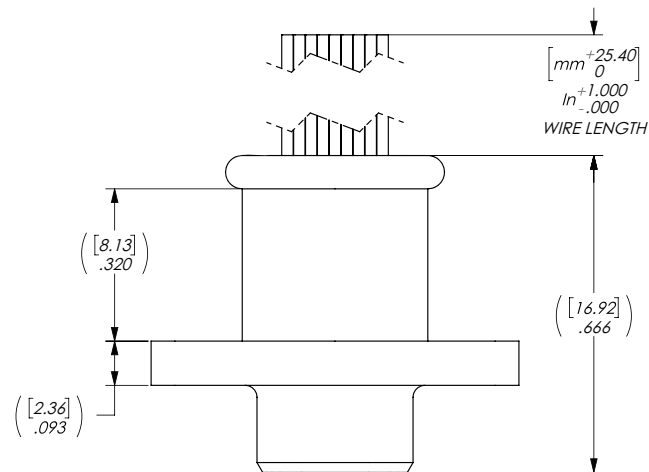
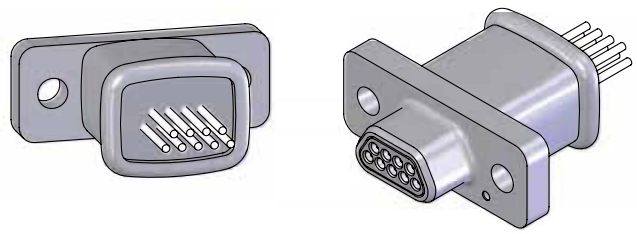


FRONT VIEW

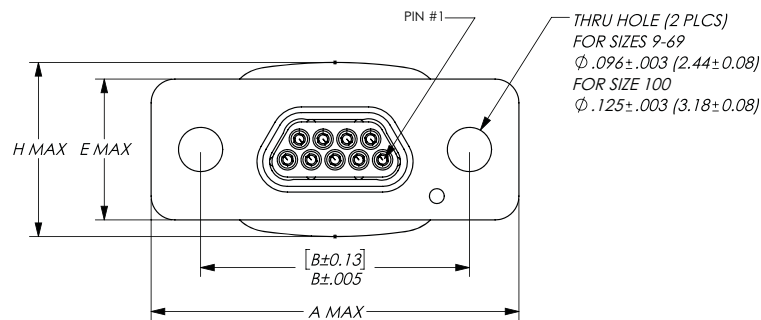
	A	B	E	H
09	.785 (19.94)	.565 (14.35)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
15	.935 (23.75)	.715 (18.16)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
21	1.085 (27.56)	.865 (21.97)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
25	1.185 (30.10)	.965 (24.51)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
31	1.335 (33.91)	1.115 (28.32)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
37	1.485 (37.72)	1.265 (32.13)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
51	1.435 (36.45)	1.215 (30.86)	.351 (8.92)	.421 (10.69)
69	1.735 (44.07)	1.515 (38.48)	.351 (8.92)	.421 (10.69)
100	2.170 (55.12)	1.800 (45.72)	.394 (10.01)	.464 (11.79)

MICRO-D BANDIT PIN

INTEGRAL BACKSHELL



TOP VIEW

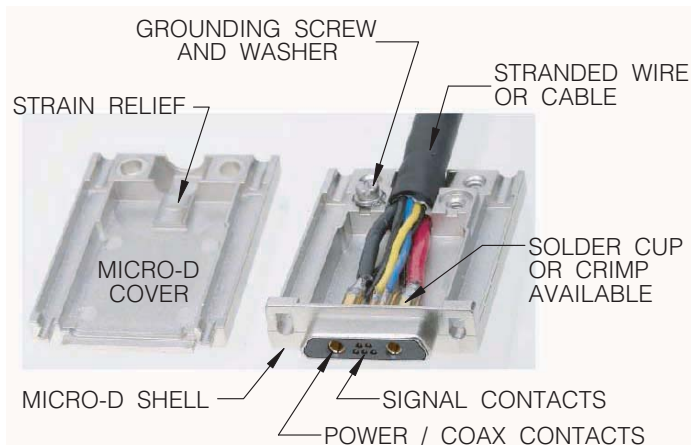
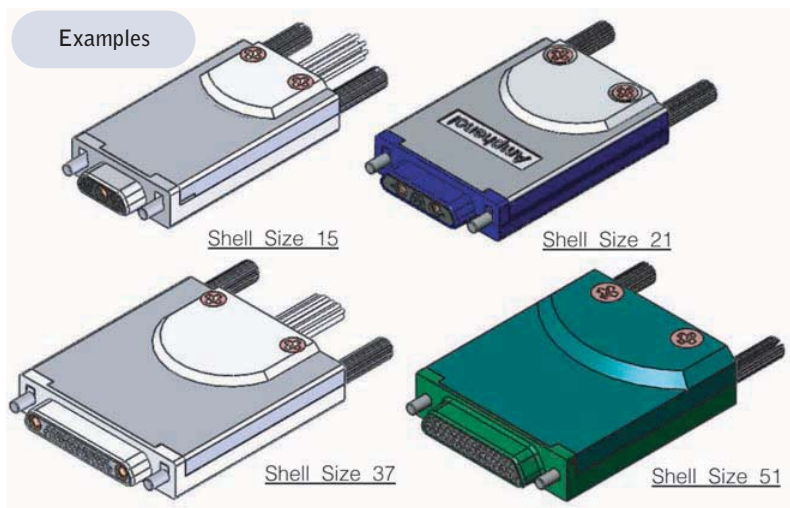
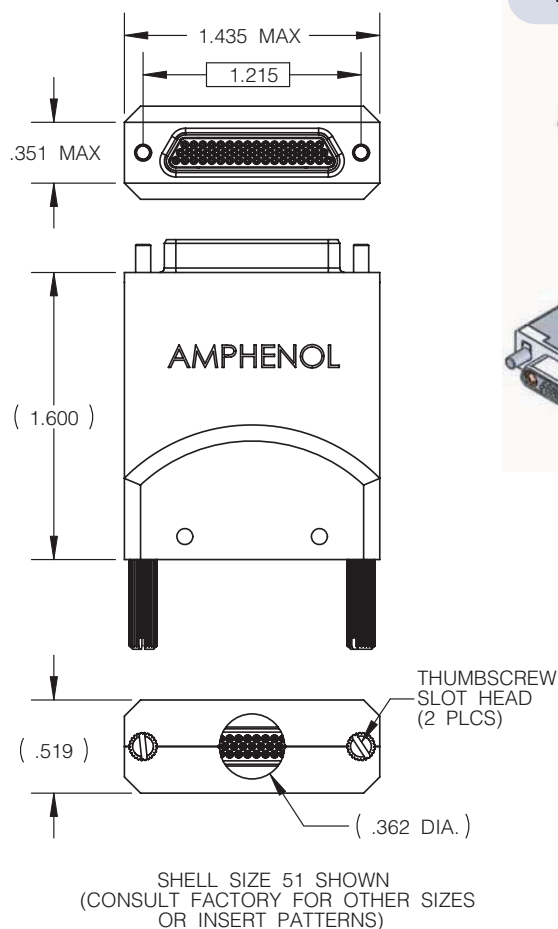


FRONT VIEW

	A	B	E	H
09	.785 (19.94)	.565 (14.35)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
15	.935 (23.75)	.715 (18.16)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
21	1.085 (27.56)	.865 (21.97)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
25	1.185 (30.10)	.965 (24.51)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
31	1.335 (33.91)	1.115 (28.32)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
37	1.485 (37.72)	1.265 (32.13)	.308 (7.82)	.378 (9.60)
51	1.435 (36.45)	1.215 (30.86)	.351 (8.92)	.421 (10.69)
69	1.735 (44.07)	1.515 (38.48)	.351 (8.92)	.421 (10.69)
100	2.170 (55.12)	1.800 (45.72)	.394 (10.01)	.464 (11.79)

MICRO-D WITH INTEGRATED EMI BACKSHELL

INCORPORATING COAX, TWINAX AND TRIAX CONTACTS



FEATURES

- Easy assembly
- All-in-one Micro-D connector and EMI backshell
- Eliminate the use of retaining clip (E-clip) hardware
- Built in strain relief
- Grounding screw and washer included
- Solder cup and wire termination available
- Sizes 9 thru 100 available
- Standard MIL-DTL-83513 insert pattern or custom insert pattern available
- Signal / Power / Coaxial contacts available
- Consult factory for angled cable exit or specific cable diameter requirement

MATERIAL & FINISH

Material: Aluminum alloy
(consult factory for zinc alloy)

Finish: Electroless nickel

Hardware: Stainless steel

PERFORMANCE INFORMATION

- D.W.V.600VAC(atsealevel)
- Insulation resistance: 5000 megaohms min.
- Temperature rating: -55 deg C to +125 deg C (+85 deg C for zinc alloy)
- Designed to meet MIL-DTL-83513 performance standards

Amphenol アンフェノール ジャパン株式会社

□ 本社・工場

〒520-3041 滋賀県栗東市出庭471-1

TEL 077-553-8503(代) FAX 077-551-2200

□ 横浜オフィス

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8

TEL 045-473-9219(代) FAX 045-473-9204

<http://www.amphenol.co.jp/military>